

2020年3月期 決算説明資料

株式会社フジミインコーポレーテッド

2020年5月21日

決算概要

【2020年3月期 業績】

✓ 売上高	+2.7%	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品の販売が好調
✓ 営業利益	+13.1%	: 最先端半導体デバイス向け製品好調、製品ミックスの良化 過去最高を更新
✓ 経常利益	+9.6%	: 過去最高を更新
✓ 当期純利益	+0.1%	: 2期連続で過去最高を更新
✓ CMP向け		: 最先端半導体デバイス向け製品の販売増加により 5期連続で過去最高売上高を更新
✓ シリコンウェハー向け		: ラッピング減収も、ポリシングは新規採用により増収
✓ ハードディスク向け		: 顧客統合によるプロセス変更に伴う使用量減等により減収
✓ 一般工業用向け		: 中国の景気減速等の影響により減収
✓ 株主還元		: 2期連続で連結配当性向 50%以上

【2021年3月期 業績予想】

次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルスが当社業績へ及ぼす影響を見通すことが困難であるため、現時点では業績予想を未定とし、合理的な算定が可能となり次第、速やかに開示致します。

なお、現時点における新型コロナウイルスの当社に及ぼす影響は、以下の通りであります。

- 需要面：新型コロナウイルスがマクロ経済へ及ぼす影響は不透明であり、今後の当社への需要動向を見通すことは困難であります。
- 供給面：当社生産状況としては、新型コロナウイルス感染防止策を徹底し通常通り稼働しております。

業績概要 (通期実績)

単位：百万円	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	期初予想 ('19/5)	通期実績	前年比	期初予想比
売上高	37,394	37,500	38,408	+2.7%	+2.4%
営業利益	5,310	4,700	6,007	+13.1%	+27.8%
営業利益率	14.2%	12.5%	15.6%	-	-
経常利益	5,637	4,800	6,177	+9.6%	+28.7%
経常利益率	15.1%	12.8%	16.1%	-	-
当期純利益	4,265	3,600	4,270	+0.1%	+18.6%
当期純利益率	11.4%	9.6%	11.1%	-	-

- (前期比) ・最先端半導体デバイス向けCMP製品の販売好調により、増収増益
 ・営業利益・経常利益ともに過去最高を更新
 ・当期純利益は過去最高を2期連続で更新

業績概要 (半期実績)

単位：百万円	19年3月期		20年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	上期比
売上高	19,163	18,231	18,884	△1.5%	+3.6%	19,523	+7.1%	+3.4%
営業利益	2,813	2,497	2,863	+1.8%	+14.7%	3,144	+25.9%	+9.8%
営業利益率	14.7%	13.7%	15.2%	-	-	16.1%	-	-
経常利益	3,056	2,580	2,974	△2.7%	+15.3%	3,202	+24.1%	+7.7%
経常利益率	15.9%	14.2%	15.8%	-	-	16.4%	-	-
当期純利益	2,339	1,926	2,212	△5.5%	+14.9%	2,058	+6.9%	△7.0%
当期純利益率	12.2%	10.6%	11.7%	-	-	10.5%	-	-

・20/3期下期業績は、CMP製品が堅調であったため、上期を上回った。

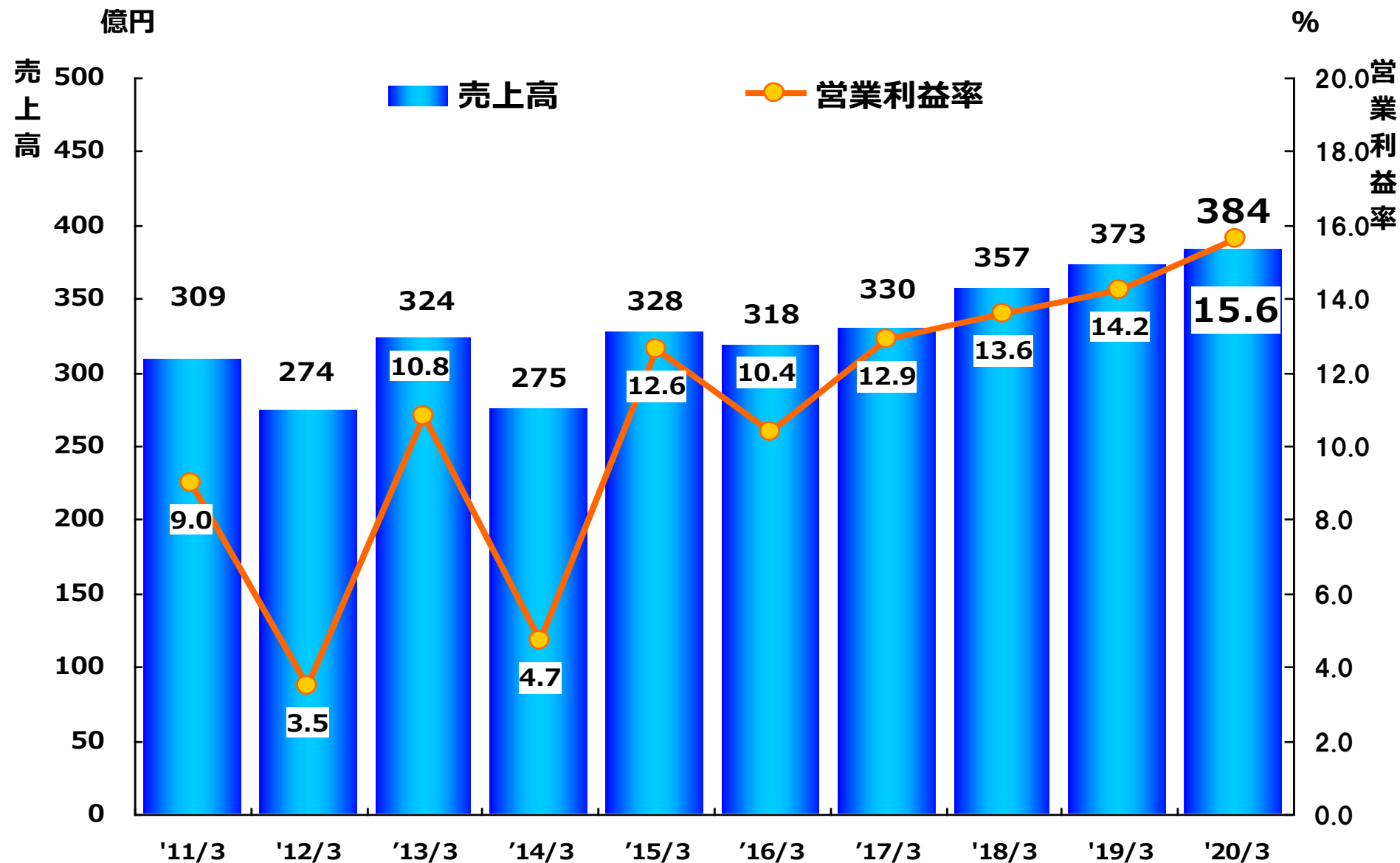
- ロジックデバイスにおける最先端プロセス立ち上げに伴う需要増
- メモリデバイスでは市況は通期で停滞するも、データセンター向けは年明け以降に需要回復

業績予想（通期）

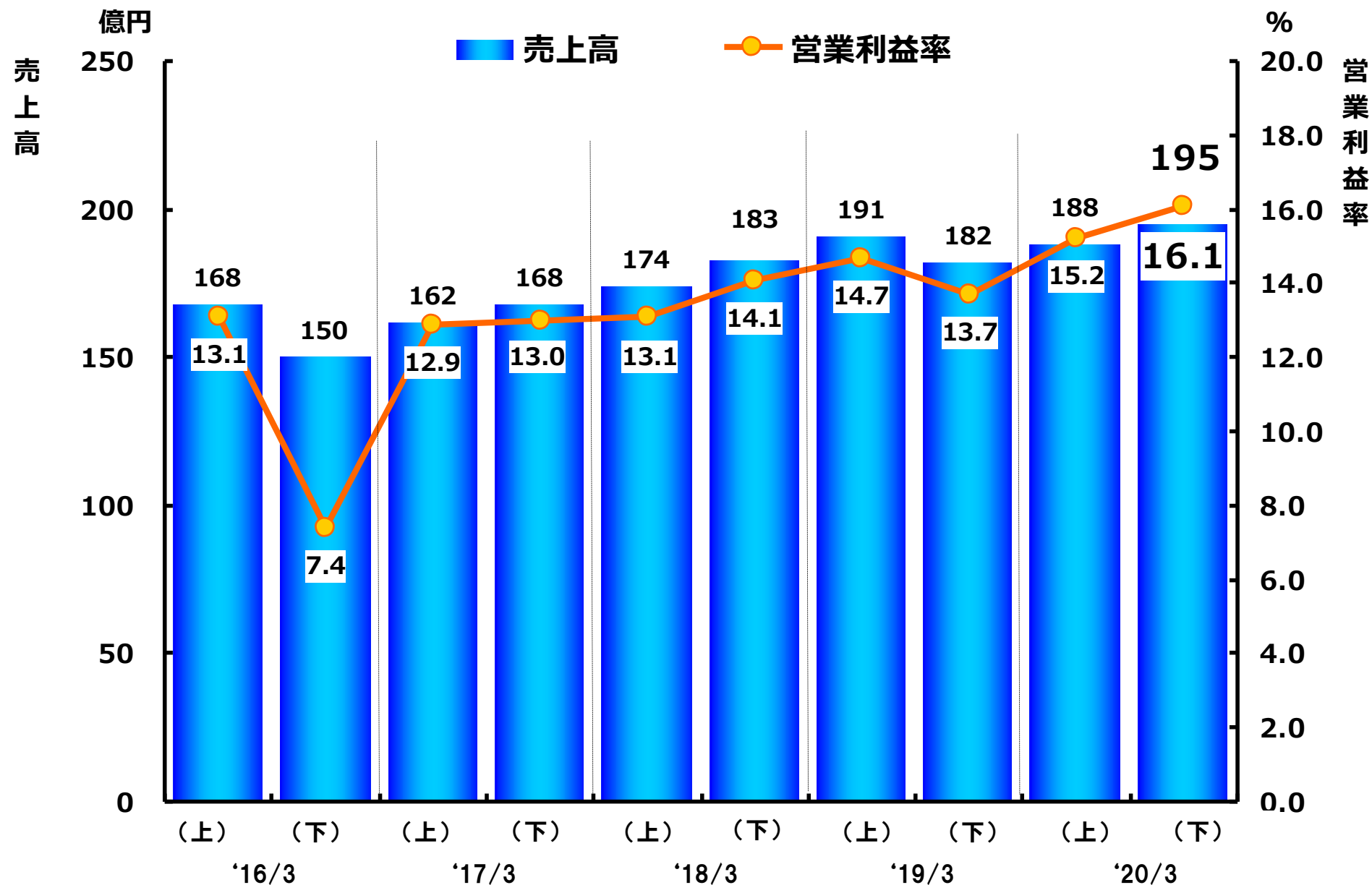
単位：百万円	19年3月期	20年3月期	21年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	37,394	38,408	未定	-
営業利益	5,310	6,007		
営業利益率	14.2%	15.6%		
経常利益	5,637	6,177		
経常利益率	15.1%	16.1%		
当期純利益	4,265	4,270		
当期純利益率	11.4%	11.1%		

次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルスが当社業績へ及ぼす影響を見通すことが困難であるため、現時点では業績予想を未定とし、合理的な算定が可能となり次第、速やかに開示致します。

業績推移 (通期)



業績推移 (半期)



用途別売上高

用途別売上高 (通期実績)

単位：百万円		19年3月期	20年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比
シリコンウエハー	ラッピング	4,297	3,838	△10.7%
	ポリシング	8,621	9,006	+4.5%
	切断	453	273	△39.8%
	計	13,373	13,118	△1.9%
CMP		15,305	17,361	+13.4%
ディスク	アルミディスク	2,171	1,961	△9.7%
	ガラスディスク	96	203	+111.2%
	計	2,268	2,164	△4.5%
機能材、溶射材	一般工業用(研磨材)	3,931	3,571	△9.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,121	1,912	△9.9%
	計	6,053	5,483	△9.4%
製品売上高		36,999	38,128	+3.1%
商品売上高		395	279	△29.3%
売上高 合計		37,394	38,408	+2.7%

用途別売上高 (半期実績)

単位：百万円		19年3月期		20年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハ	ラッピング	2,176	2,120	1,834	△15.7%	△13.5%	2,004	△5.5%	+9.3%
	ポリシング	4,301	4,319	4,487	+4.3%	+3.9%	4,519	+4.6%	+0.7%
	切断	228	225	137	△40.0%	△39.3%	136	△39.6%	△0.5%
	計	6,706	6,666	6,458	△3.7%	△3.1%	6,660	△0.1%	+3.1%
CMP		7,690	7,614	8,483	+10.3%	+11.4%	8,878	+16.6%	+4.7%
ディスク	アルミディスク	1,225	946	983	△19.8%	+3.9%	978	+3.5%	△0.4%
	ガラスディスク	51	45	111	+117.3%	+145.7%	92	+104.2%	△16.9%
	計	1,276	991	1,094	△14.3%	+10.4%	1,070	+8.0%	△2.1%
機能材 溶射材	一般工業用(研磨材)	2,212	1,718	1,740	△21.4%	+1.2%	1,831	+6.6%	+5.2%
	一般工業用(非研磨材)	1,070	1,051	949	△11.4%	△9.7%	963	△8.3%	+1.5%
	計	3,283	2,769	2,689	△18.1%	△2.9%	2,794	+0.9%	+3.9%
製品売上高		18,957	18,042	18,724	△1.2%	+3.8%	19,404	+7.6%	+3.6%
商品売上高		206	189	160	△22.4%	△15.5%	119	△36.8%	△25.2%
売上高 合計		19,163	18,231	18,884	△1.5%	+3.6%	19,523	+7.1%	+3.4%

シリコンウェハー売上高 (通期・半期実績)

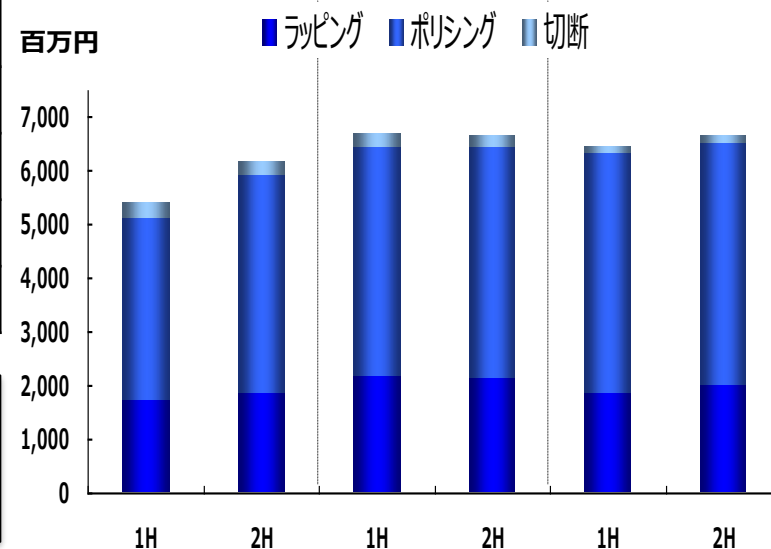
<<通期>>

単位：百万円		19年3月期		20年3月期	
		通期実績		通期実績	
				前年比	
シリコンウェハー	ラッピング	4,297		3,838 Δ 10.7%	
	ポリシング	8,621		9,006 +4.5%	
	切断	453		273 Δ 39.8%	
	計	13,373		13,118 Δ 1.9%	

<<半期>>

単位：百万円		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績
シリコンウェハー	ラッピング	2,176	2,120	1,834	2,004
	ポリシング	4,301	4,319	4,487	4,519
	切断	228	225	137	136
	計	6,706	6,666	6,458	6,660

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期



【ラッピング】 特に小口径シリコンウェハー市場の減速により減収

【ポリシング】 新規採用の拡大により増収

CMP売上高 (通期・半期実績)

<<通期>>

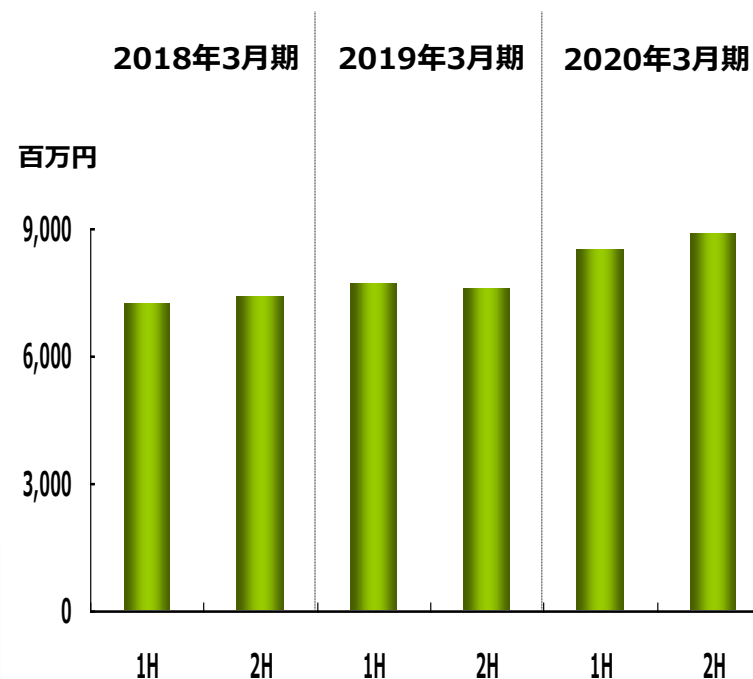
単位：百万円	19年3月期	20年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比
CMP	15,305	17,361	+13.4%

<<半期>>

単位：百万円	19年3月期		20年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績
CMP	7,690	7,614	8,483	8,878

以下要因により増収

- ロジックデバイスにおける最先端プロセス立ち上げに伴う需要増
- メモリデバイスではデータセンター向けは年明け以降に需要回復



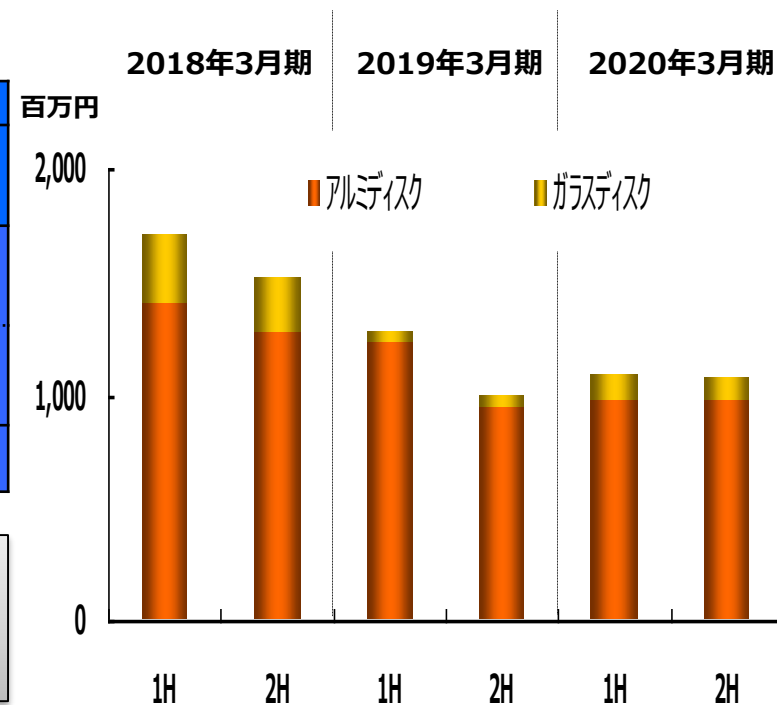
ディスク売上高 (通期・半期実績)

<<通期>>

単位：百万円		19年3月期	20年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比
ディスク	アルミディスク	2,171	1,961	△9.7%
	ガラスディスク	96	203	+111.2%
	計	2,268	2,164	△4.5%

<<半期>>

単位：百万円		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績
ディスク	アルミディスク	1,225	946	983	978
	ガラスディスク	51	45	111	92
	計	1,276	991	1,094	1,070



【アルミ】 市場縮小と顧客統合による生産プロセス変更により減収

【ガラス】 顧客都合による一時的な増収

機能材・溶射材売上高 (通期・半期実績)

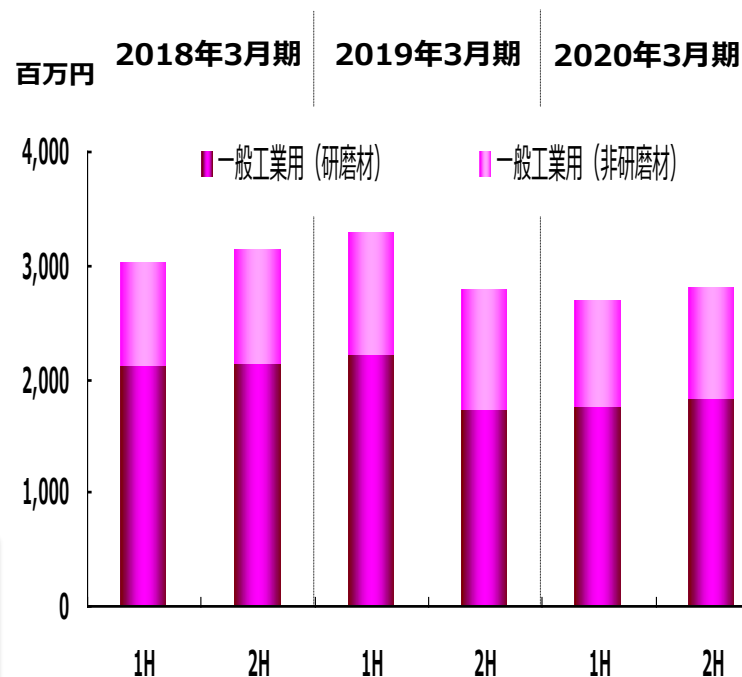
<<通期>>

単位：百万円		19年3月期		20年3月期	
		通期実績		通期実績	
				前年比	
機能材・溶射材	一般工業用 (研磨材)	3,931		3,571	△9.2%
	一般工業用 (非研磨材)	2,121		1,912	△9.9%
	計	6,053		5,483	△9.4%

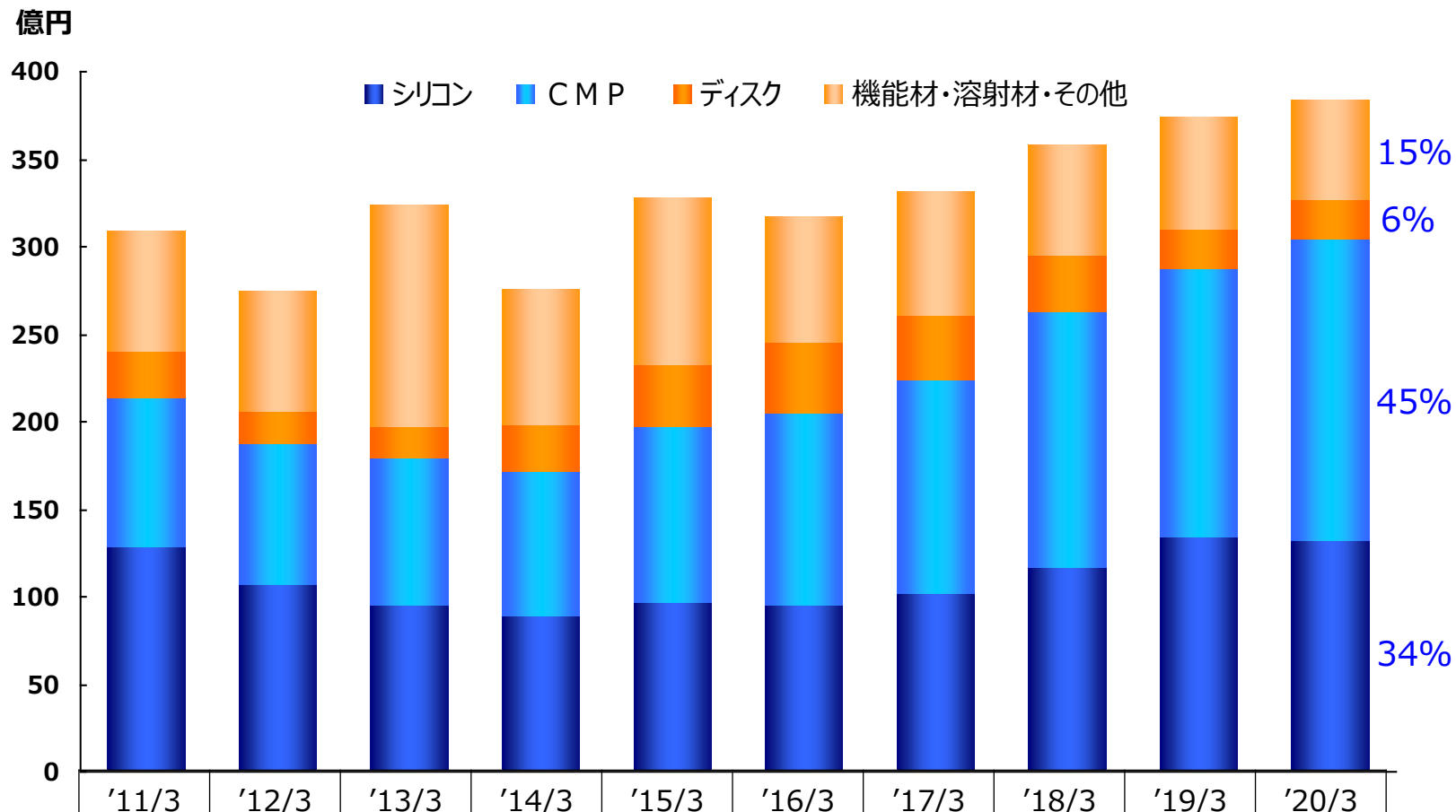
<<半期>>

単位：百万円		19年3月期		20年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績
機能材・溶射材	一般工業用 (研磨材)	2,212	1,718	1,740	1,831
	一般工業用 (非研磨材)	1,070	1,051	949	963
	計	3,283	2,769	2,689	2,794

【研磨材】 研削砥石、コーティング向け等で減収
 【非研磨材】 半導体・FPD製造装置向け等で減収

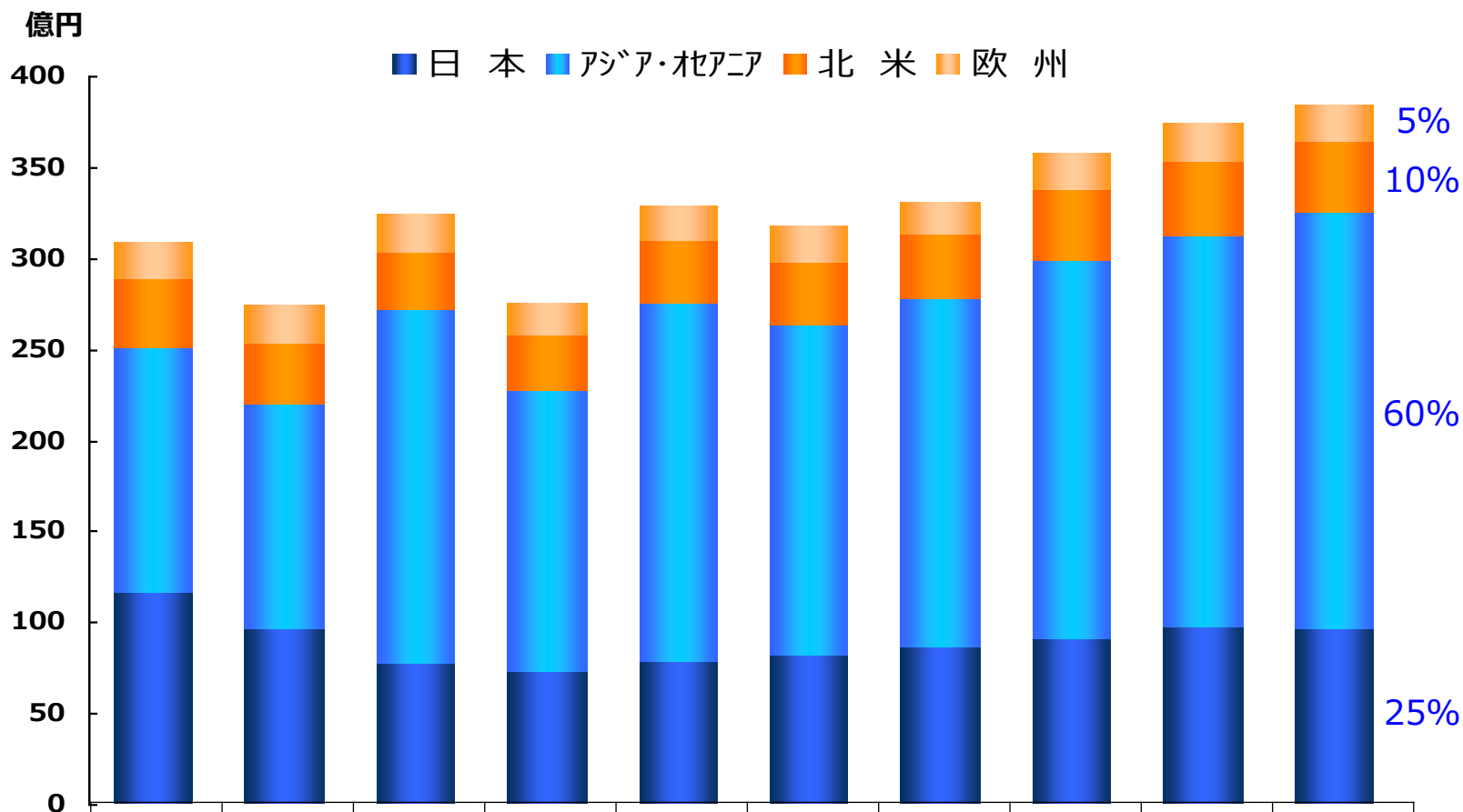


用途別売上高 (通期)



	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3
機能材・溶射材・その他	68	69	127	77	96	72	70	63	64	57
ディスク	26	17	18	26	34	40	36	32	22	21
CMP	85	80	83	82	101	109	122	146	153	173
シリコン	127	106	94	88	95	94	100	115	133	131
計	308	274	324	274	328	317	330	357	373	384

地域別売上高 (通期 仕向先別)

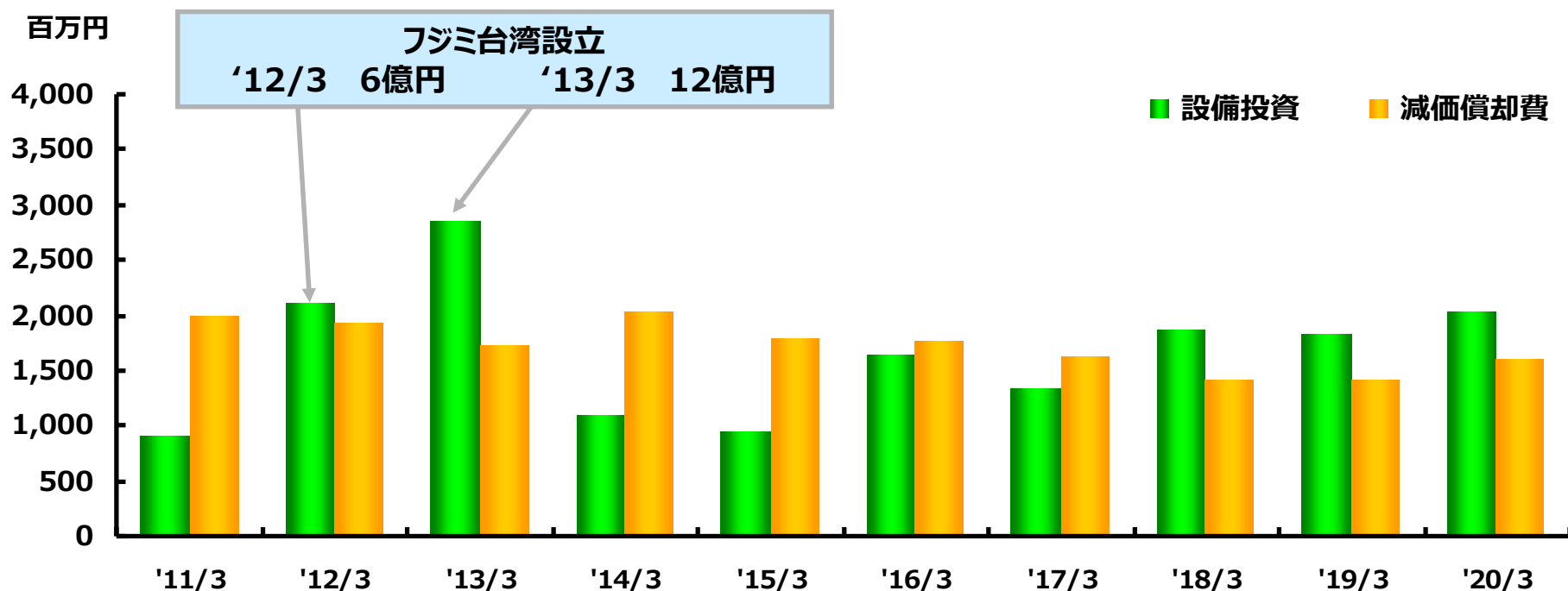


	'11/3	'12/3	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3
欧州	19	21	21	17	18	19	18	20	21	20
北米	38	32	30	30	35	34	35	39	40	38
アジア・オセアニア	134	123	195	154	196	182	191	208	215	229
日本	115	95	76	72	77	81	85	90	96	95
計	308	274	324	274	328	317	330	357	373	384

設備投資・減価償却費・研究開発費

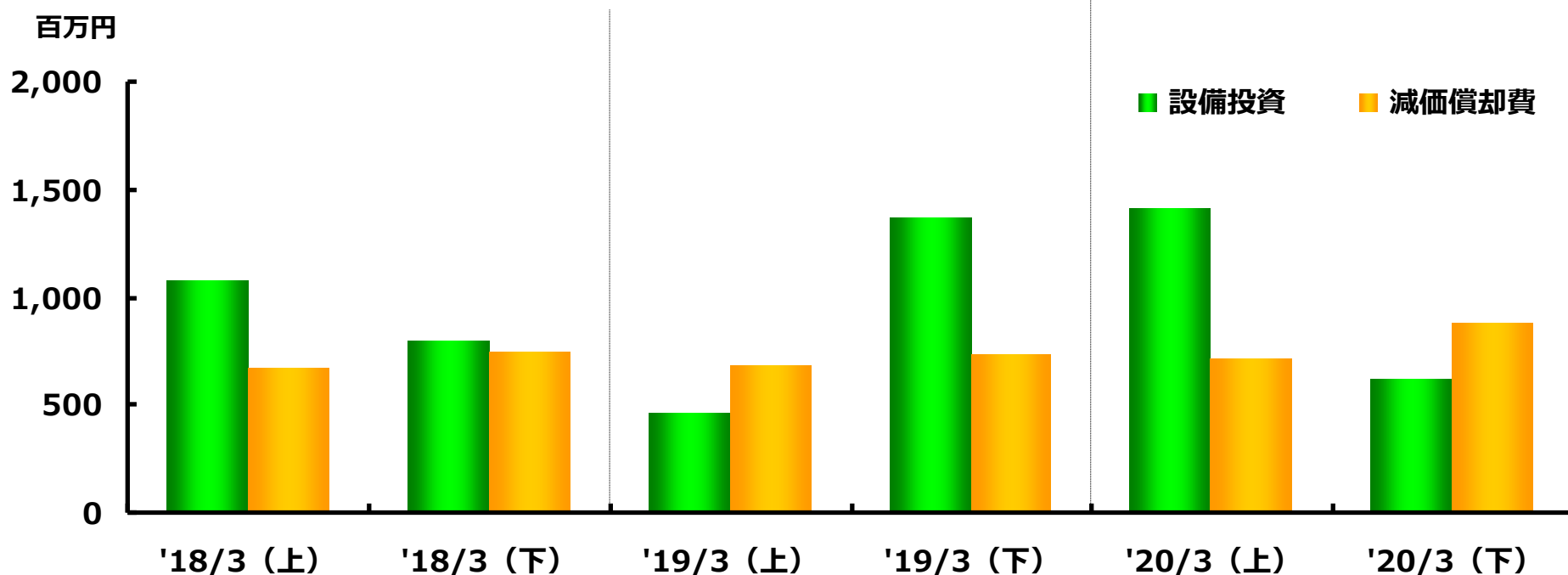
設備投資・減価償却費（通期実績）

単位：百万円	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比
設備投資	1,829	2,800	2,030	+11.0%	△27.5%
減価償却費	1,413	1,600	1,598	+13.1%	△0.1%



設備投資・減価償却費（半期実績）

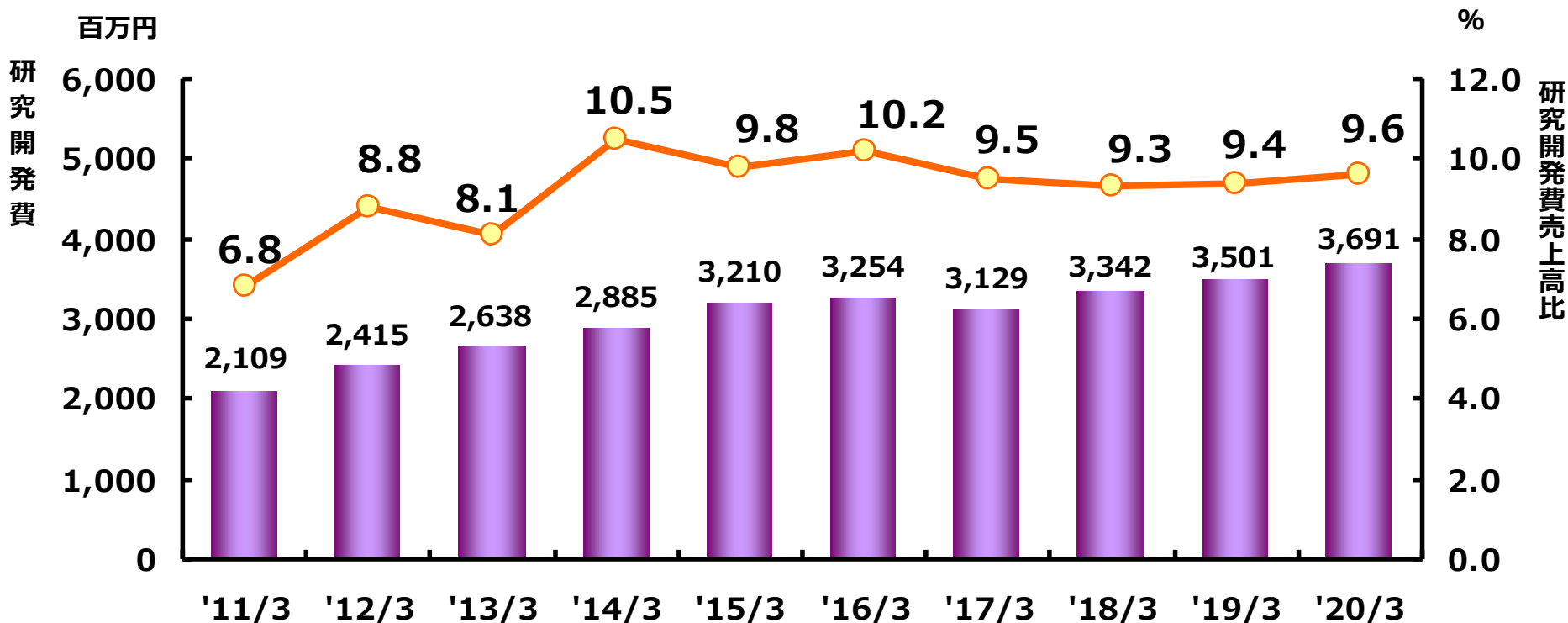
単位：百万円	19年3月期		20年3月期			
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比
設備投資	461	1,368	1,409	621	△54.6%	△55.9%
減価償却費	684	729	715	883	+21.1%	+23.5%



研究開発費／売上高比（通期実績）

単位：百万円	19年3月期	20年3月期			
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比
研究開発費	3,501	3,700	3,691	+5.4%	△0.2%

売上高比

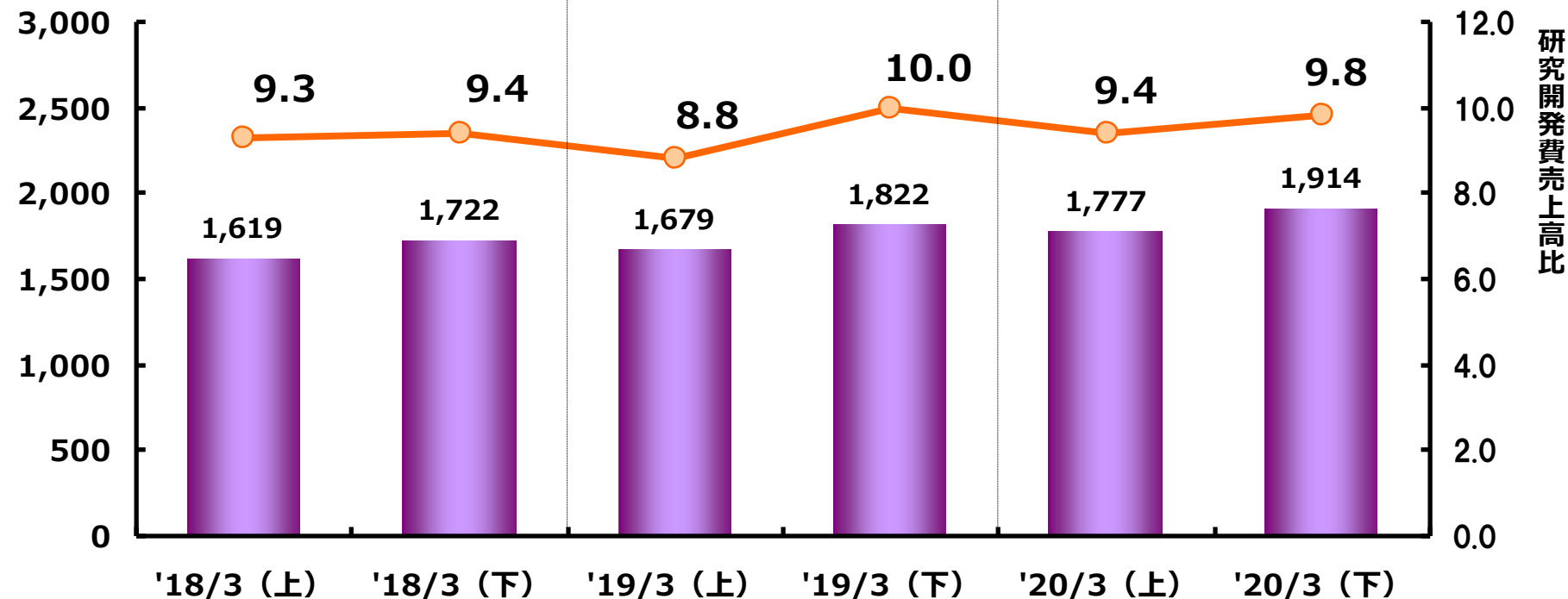


研究開発費／売上高比（半期実績）

単位：百万円	19年3月期		20年3月期			
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	上期比
研究開発費	1,679	1,822	1,777	1,914	+5.0%	+7.7%

売上高比

百万円



損益分析

営業利益増減要因

19/3期実績→20/3期実績

売上高 373億円

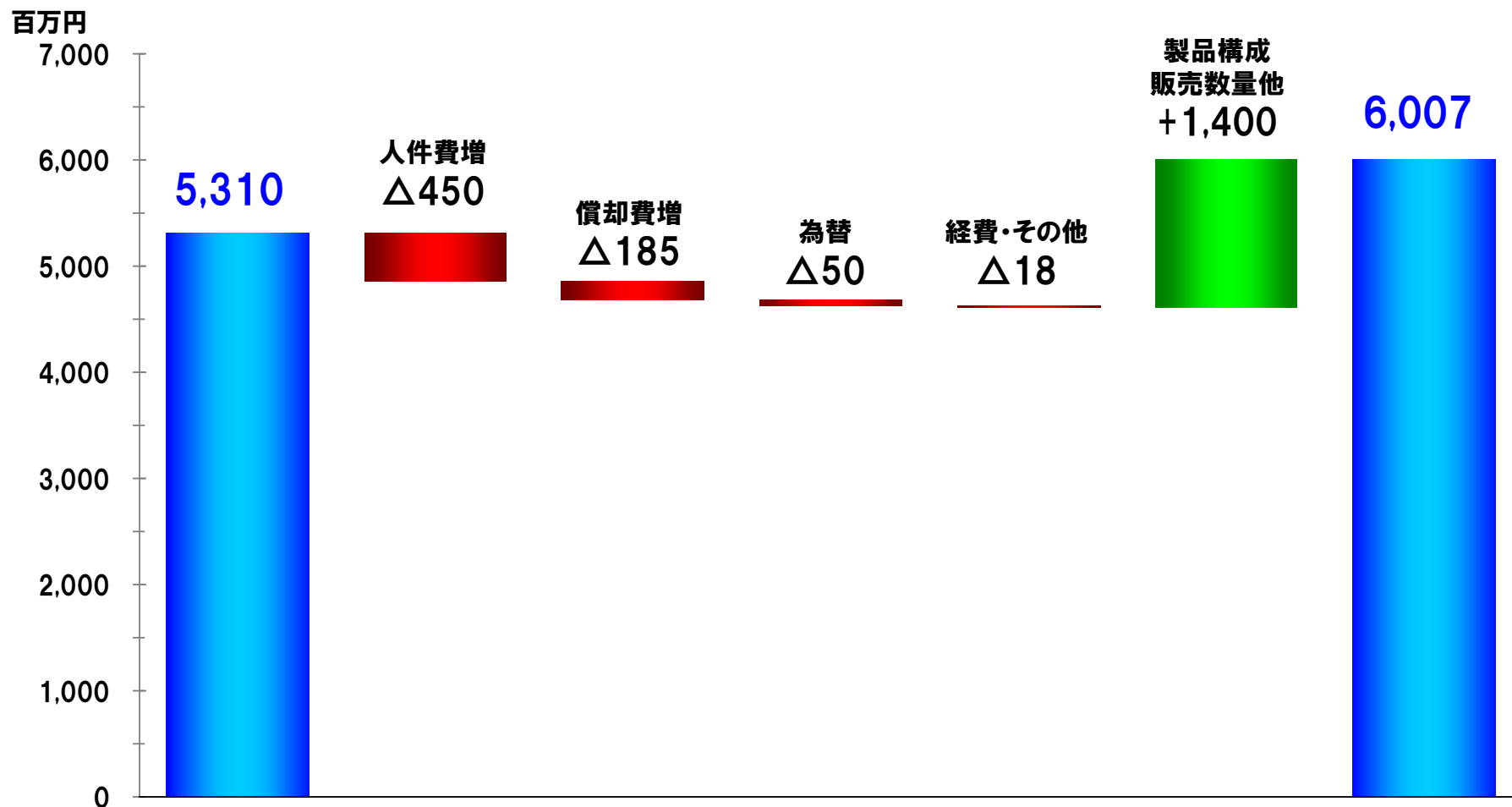
19/3期
実績

(売上増) +1,014百万円

(利益増) +697

384億円

20/3期
実績



株主還元

■ 利益配分に関する基本方針

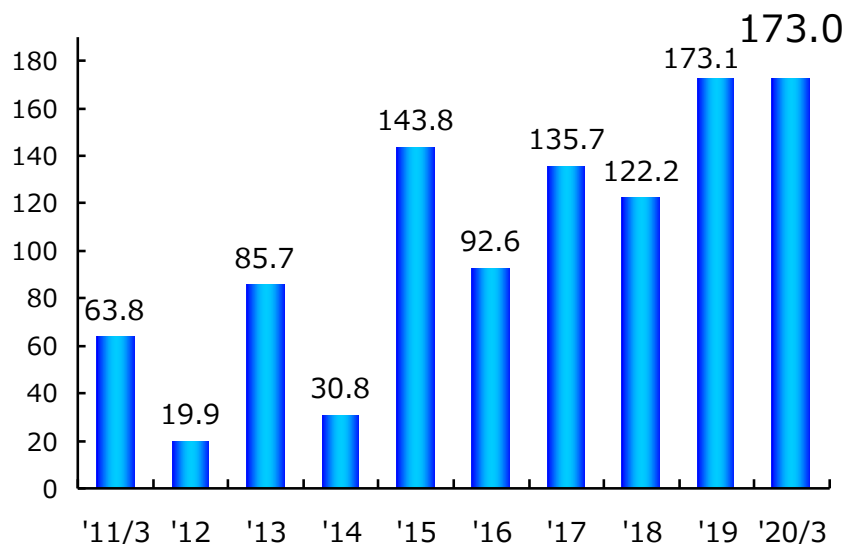
1. 連結配当性向 50%以上
2. 安定配当の継続

■ 1株当たり配当金 **2期連続で連結配当性向50%超**

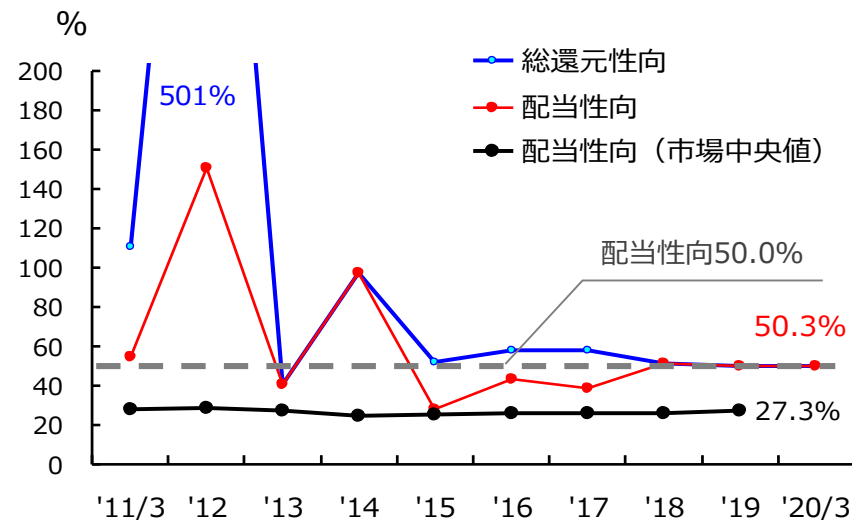
	2019/3月期		2020/3月期	
	期初予想 2018/5/11	実績 2019/5/10	期初予想 2019/5/10	実績 2020/5/13
中間配当金	40円 (予想)	40円 (実績)	40円 (予想)	40円 (実績)
期末配当金	40円 (予想)	47円 (実績)	40円 (予想)	47円 (実績)
年間配当金	80円 (予想)	87円 (実績)	80円 (予想)	87円 (実績)
配当性向	50.6% (予想)	50.3% (実績)	54.9% (予想)	50.3% (実績)

円

1株当たり当期純利益

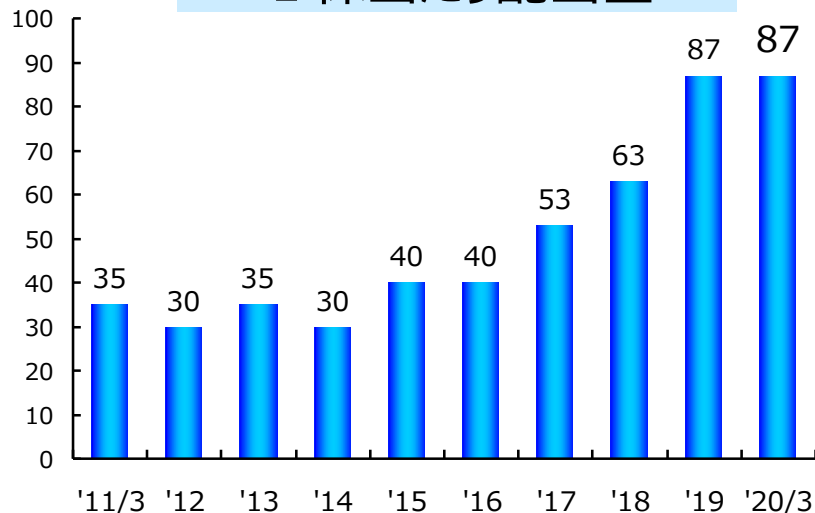


総還元性向・配当性向



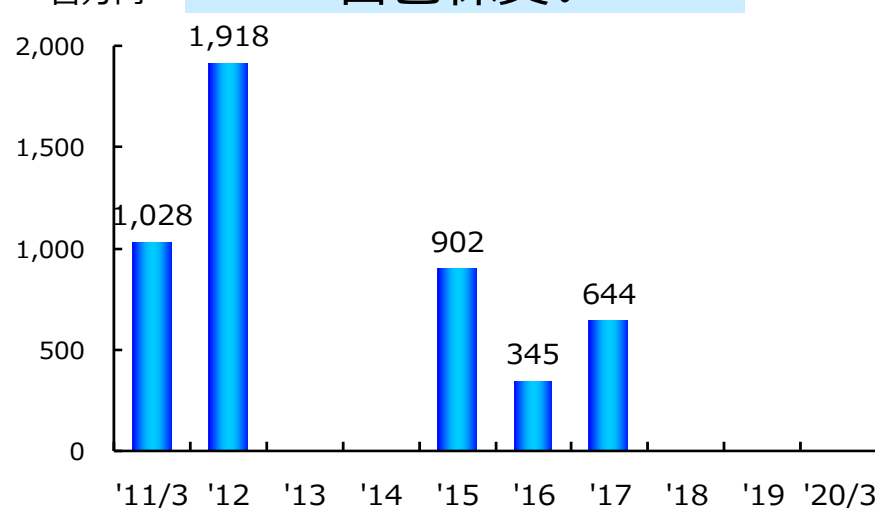
円

1株当たり配当金



百万円

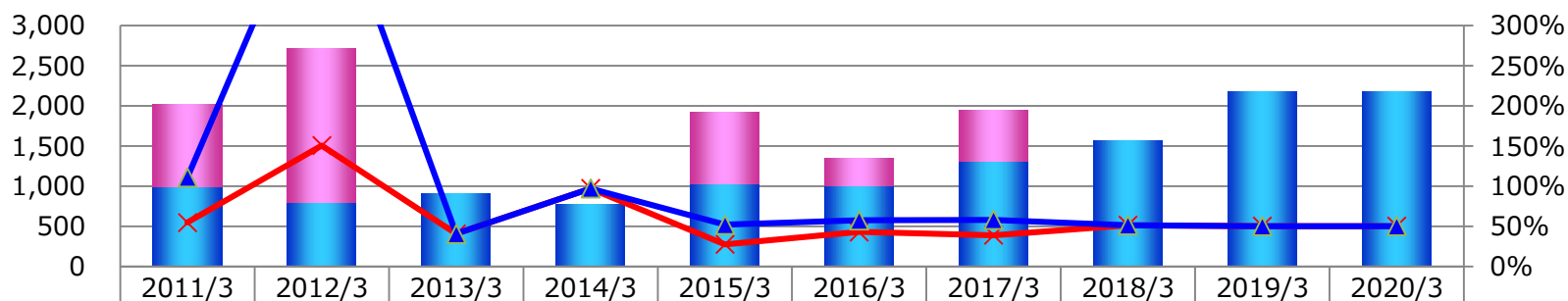
自己株買い



積極的な株主還元と安定配当の継続

(百万円)

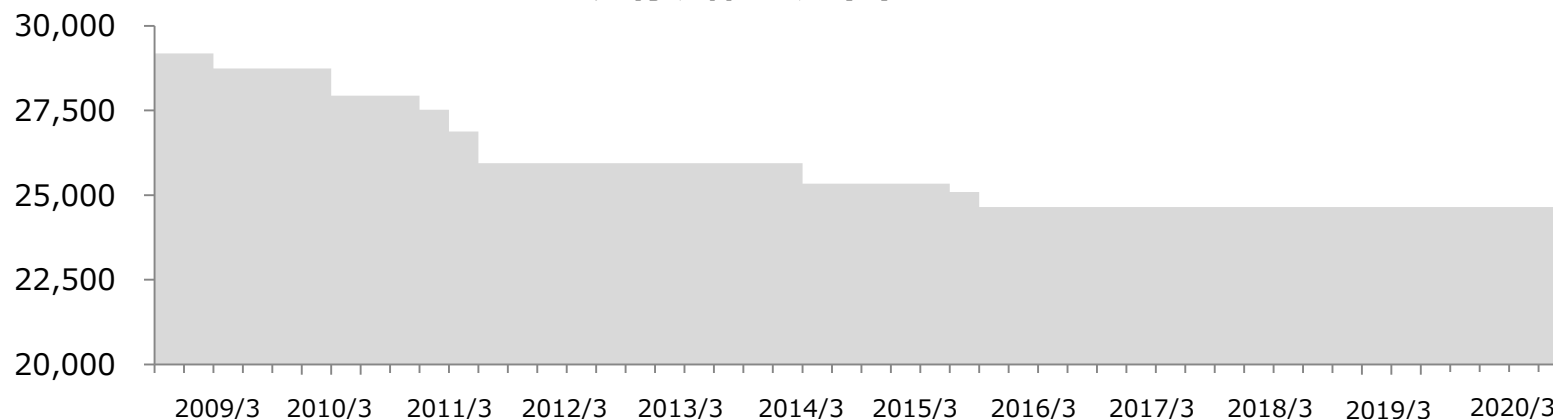
配当総額と配当性向



	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3
自己株式取得	1,028	1,918	0	0	902	345	644	0	0	0
現金配当	989	801	907	778	1,022	1,008	1,306	1,567	2,177	2,177
配当性向	54.8%	150.7%	40.8%	97.3%	27.8%	43.2%	39.0%	51.6%	50.3%	50.3%
総還元性向	110.8%	500.8%	40.8%	97.3%	52.1%	57.7%	58.2%	51.6%	50.3%	50.3%
1株当たり配当金 (円)	35	30	35	30	40	40	53	63	87	87

(千株)

発行済株式数 (*)



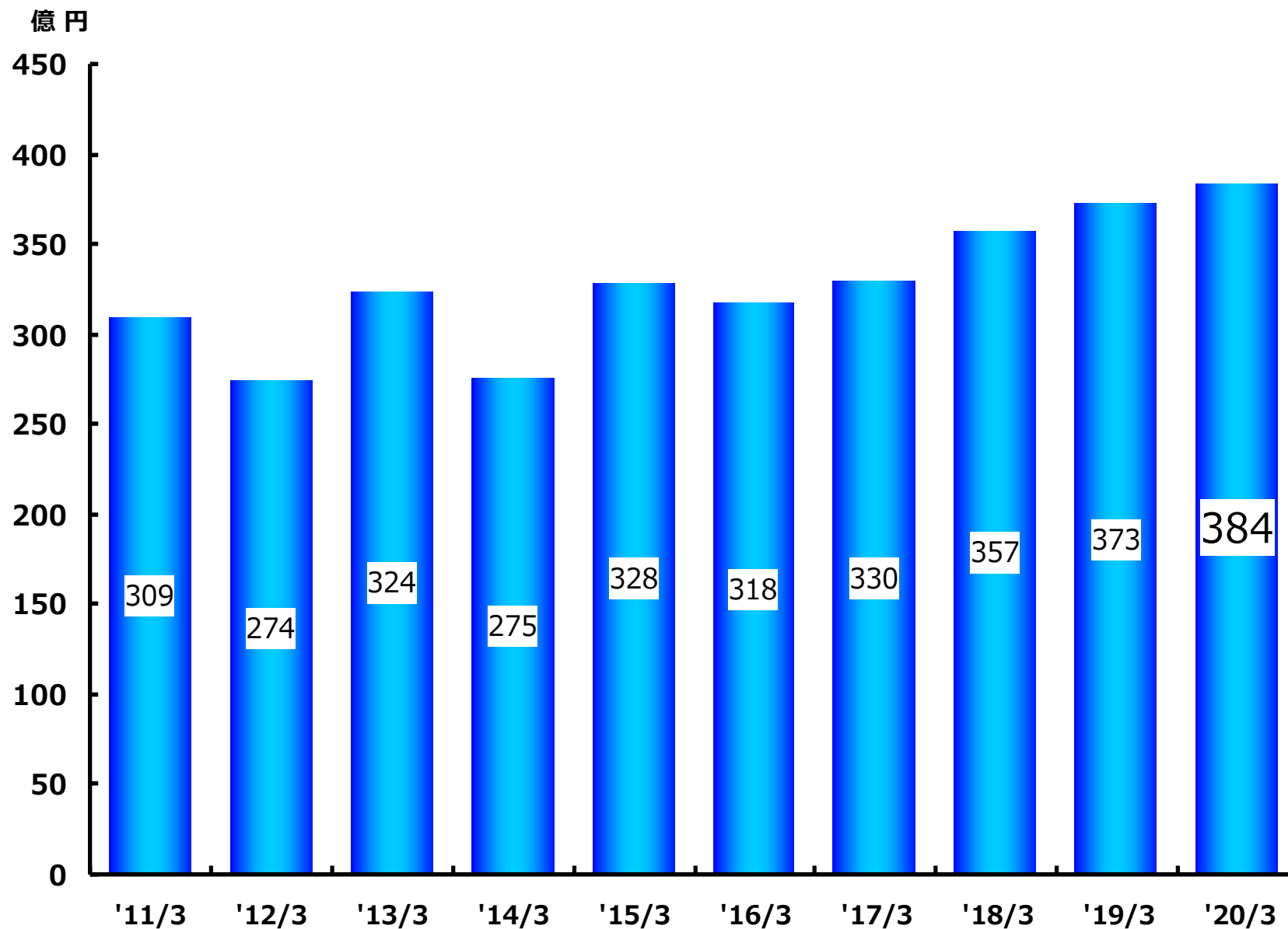
*自己株式は除く

補足資料

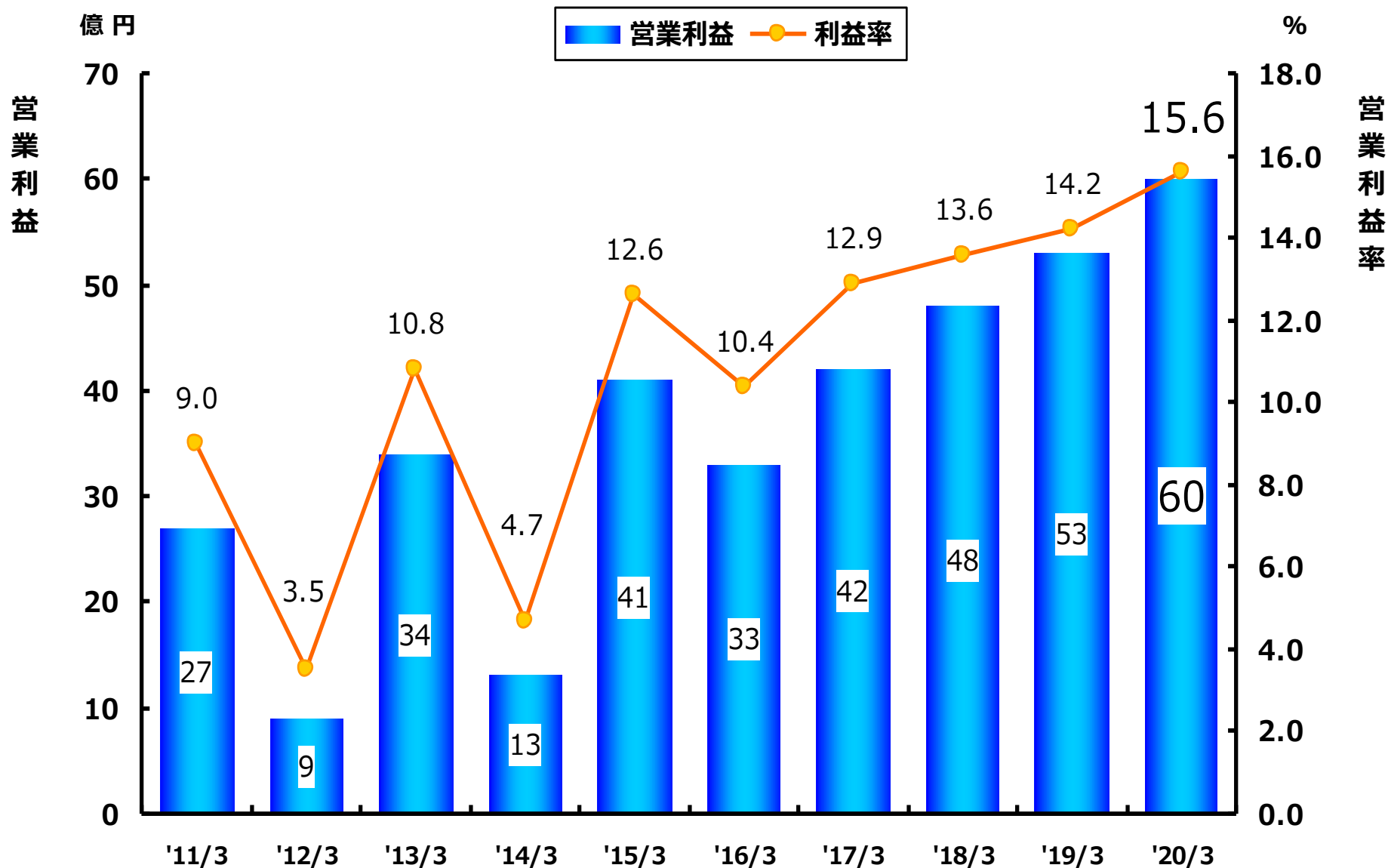
グループ人員 内訳

(人数)	19年3月期 (3月31日現在)		20年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者*	正社員	臨時 雇用者*	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者*
フジミインコーポレーテッド	588	193	636	192	+48	△1
フジミコーポレーション	114	3	108	1	△6	△2
フジミ台湾	77	1	86	2	+9	+1
フジミマイクロテクノロジー	66	7	66	5	-	△2
フジミヨーロッパ	5	1	5	2	-	+1
フジミ韓国	6	0	4	1	△2	+1
フジミ深圳	5	1	3	1	△2	-
合 計	861	206	908	204	+47	△2

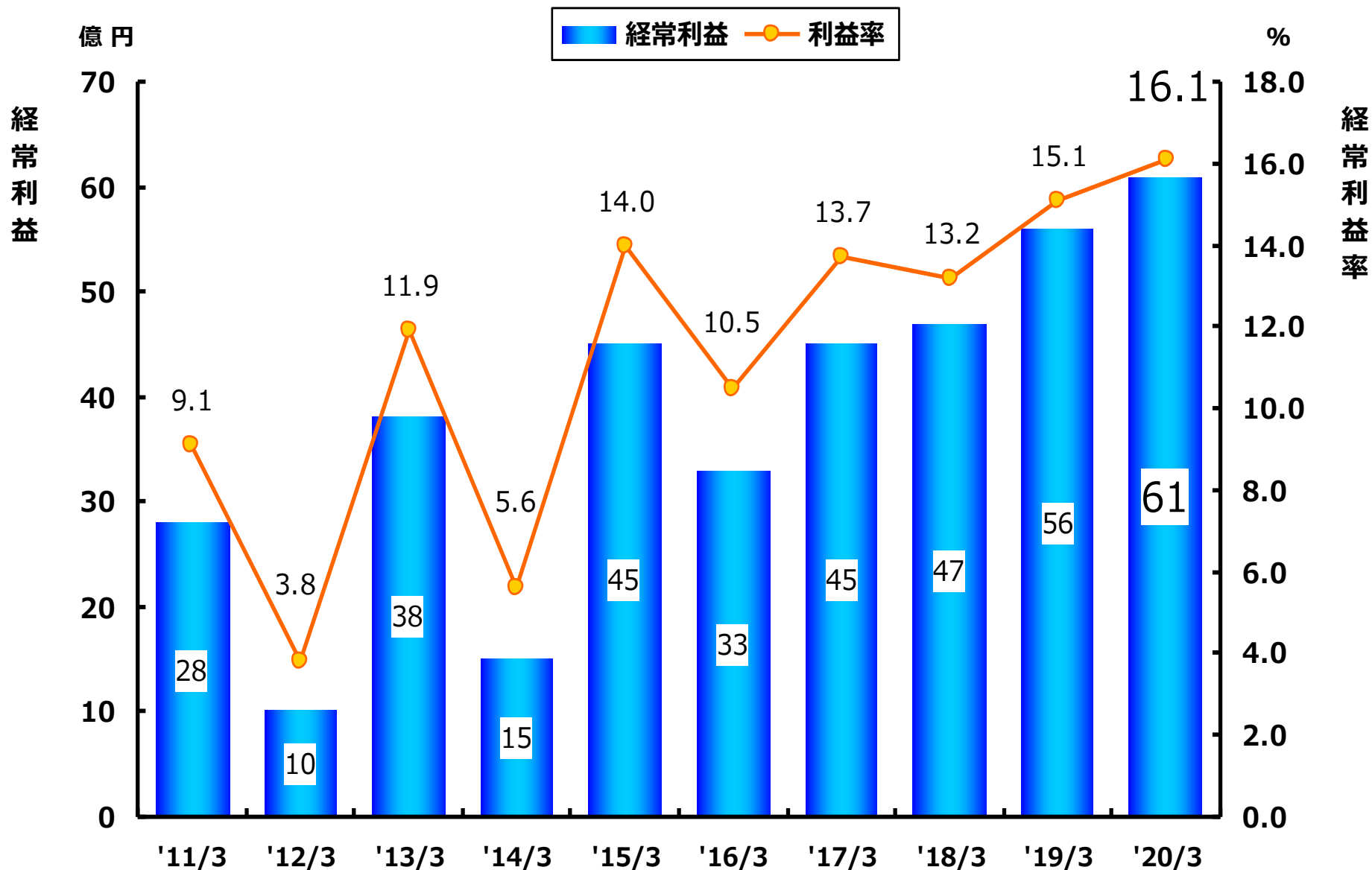
売上高 (通期)



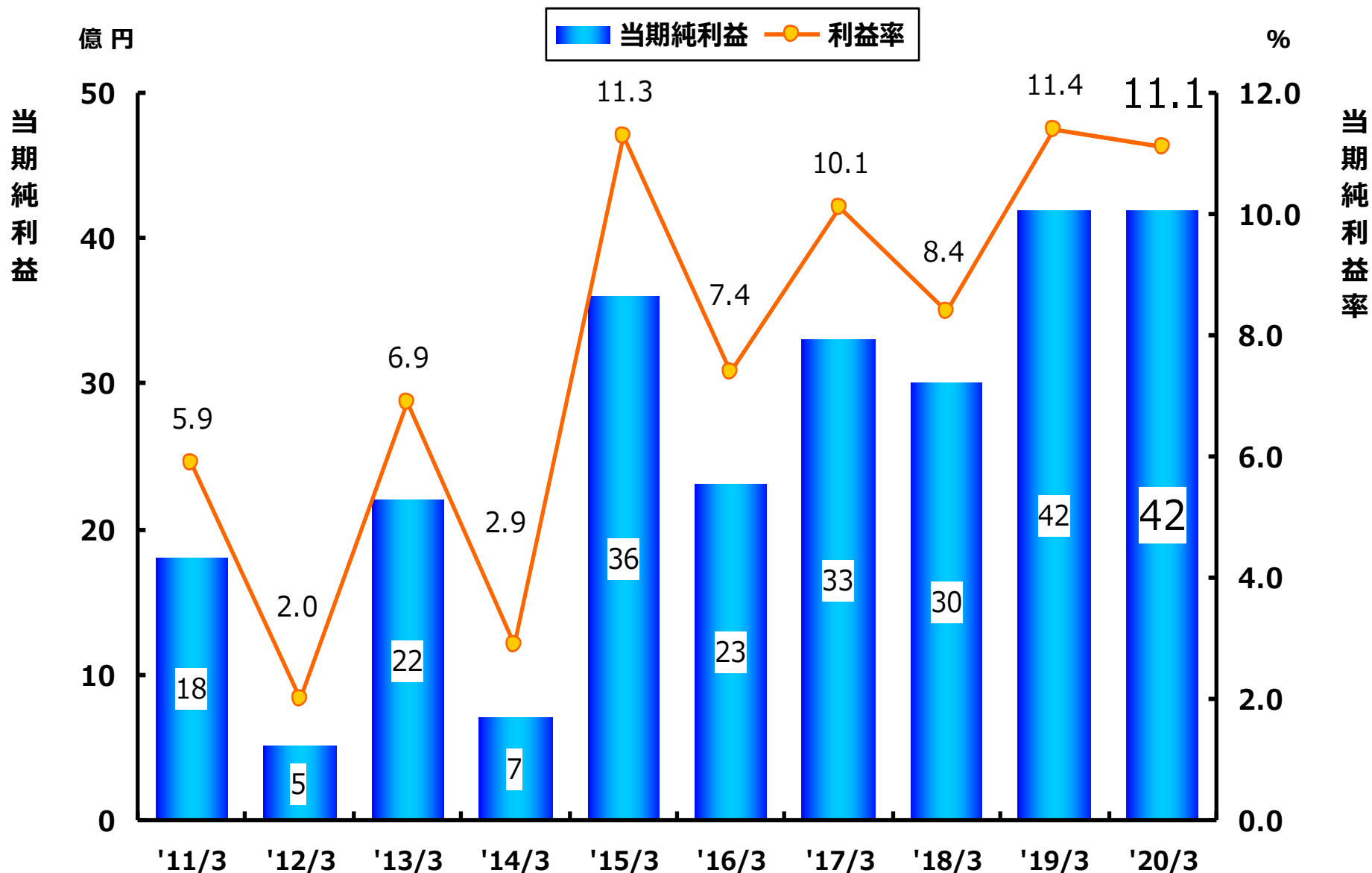
営業利益 (通期)



経常利益 (通期)

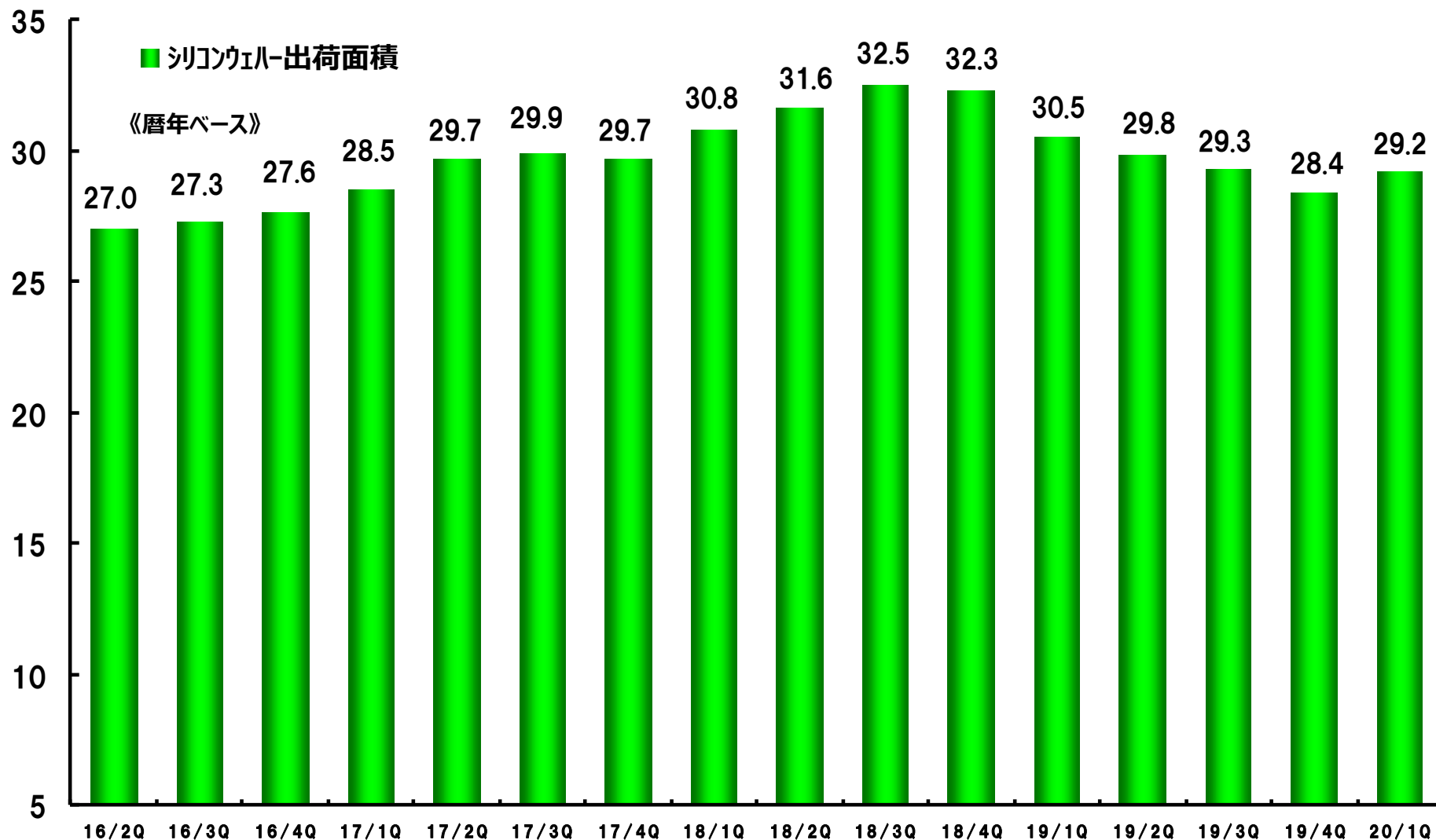


当期純利益 (通期)



シリコンウェハー出荷面積 (四半期)

億平方インチ



出所: SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

半導体市場規模 (地域別)

(単位：億ドル)

